

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2026-034

## 通富微电子股份有限公司

### 关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为全面贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”以及国务院常务会议指出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召，通富微电子股份有限公司（以下简称“通富微电”或“公司”）已于2024年8月27日披露了《关于质量回报双提升行动方案的公告》（以下简称“行动方案”）。

自行动方案发布以来，公司持续推动各项相关工作落地见效。现根据深圳证券交易所《关于深入开展深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议》的要求，对行动方案2025年度实施进展情况进行全面评估。具体情况如下：

#### 一、专注主业，深耕集成电路封装测试领域

公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供设计仿真和封装测试一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。面对2025年半导体行业强势复苏以及结构性分化的格局，公司坚持“快决策、强分析、精运营”，在诸多挑战下，积极调控，抓住市场机遇。2025年，公司营收与利润双双创出历史新高，经营质效迈上新台阶，续写高质量发展新篇章。

2025年，公司坚持以方案竞争力为中心，系统化推进通富标准方案；紧扣产业发展大势，持续加大投入，提升投资有效性；扎实推进降本工作，持续提升成本管控能力；聚焦生产效率、交付能力、工程能力，强化在市场上的竞争优势；狠抓质量和交付两个环节，为高质量运营保驾护航；优化人员结构，推动人才梯队建设。通过上述举措，推动组织高效运转，资产运营效率不断提升。2025年，

公司实现营业收入 279.21 亿元，同比增长 16.92%。根据芯思想研究院发布的 2025 年全球委外封测榜单，公司在全球前十大封测企业中排名不变。

2025 年，公司实现归属于母公司股东的净利润 12.19 亿元，同比增长 79.86%。2025 年，全球半导体产业在人工智能、高性能计算、数据中心基础设施建设等需求的拉动下，延续增长态势，逻辑 IC 与存储芯片尤其涨势强劲。报告期内，公司积极进取，产能利用率提升，营业收入增幅上升，特别是中高端产品营业收入明显增加。同时，得益于加强经营管理及成本费用的管控，公司整体效益显著提升。此外，公司准确把握产业发展趋势，围绕供应链及上下游布局产业投资，取得了较好的投资收益，增厚了公司 2025 年业绩。

2025 年，我们经历了全球产业链震荡、行业需求结构性波动及技术迭代加速等多重考验，也曾面临核心材料供应紧张、市场竞争激烈的严峻挑战。面对这些前所未有的挑战，全体通富人苦练内功，攻坚克难，一腔热血，一路前行，同心聚力，躬身实干，功不唐捐，玉汝于成。圆满完成了各项核心目标，以扎实的业绩赢得客户、员工、股东的满意与信任！

## **二、持续加大研发投入，发展新质生产力**

公司建有国家认定企业技术中心、国家级博士后科研工作站、省级技术中心和工程技术研究中心等高层次创新平台，拥有一支专业的研发队伍，先后与中科院微电子所、中科院微系统所、清华大学、北京大学、华中科技大学等知名科研院所和高校建立了紧密的合作关系，并聘请多位专家共同参与新品新技术的开发工作。

作为国家高新技术企业，公司先后承担了多项国家级技术改造、科技攻关项目，持续进行关键方向及先进技术的开发，取得了丰硕的技术创新成果，例如，大尺寸多芯片 Chiplet 封装取得重要优化进展，通过改进封装结构设计和材料工艺，成功提升了封装密度、散热性能和整体可靠性；FCCSP SOC 电容背贴产品通过考核并进入量产；存储芯片上持续加强高堆叠、定制化材料、超厚金属层切割控制等关键方向的技术升级。

2025 年，公司研发投入 15.92 亿元，较去年增加 3.85%。同时，公司在发展过程中不断加强自主创新，并在多个先进封装技术领域积极开展国内外专利布局。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计国内外专利申请达 1,779 件，其中发明专利

占比约 70%，授权专利总量突破 800 项，形成了涵盖传统封装和先进封装的全方位知识产权保护网络，为公司高质量发展注入创新动能。同时，公司先后从富士通、卡西欧、AMD 获得技术许可，使公司快速切入相关封测领域，为公司进一步向高阶封测迈进，奠定坚实的技术基础。

公司紧紧抓住市场发展机遇，面向未来高附加值产品以及市场热点方向，立足长远，大力开发扇外型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能；此外，积极布局 Chiplet、2D+ 等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势。

公司的产品、技术、服务全方位涵盖人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等领域。广泛的产品布局优势，有利于实现多元化增长动能，有效对冲行业周期性波动风险。

### **三、重视投资者回报，现金分红保障股东共享公司发展成果**

提高公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是公司发展中的核心要务。公司持续践行“以投资者为本”的发展理念，高度重视对投资者的合理投资回报，致力于以良好的经营业绩为股东创造持续稳定的投资回报。公司遵照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，并结合公司实际发展、未来规划等情况，制定合理的分红方案。公司 2025 年向股东分配的现金红利超人民币 0.68 亿元。此外，根据 2025 年度利润分配预案（尚需经股东会审议），公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.81 元（含税），现金分红总额约为 1.23 亿元（含税）。

2026 年，公司将继续聚焦主营业务，全面提升经营质量，构建企业的可持续发展，秉承积极回报投资者的发展理念，统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，匹配好资本开支、经营性资金需求与现金分红的关系，在符合相关法律法规及《公司章程》的前提下，坚持为投资者提供持续、稳定的现金分红方案，与广大投资者共享公司发展成果。

### **四、加强投资者沟通，传递公司价值**

公司深知在快速发展的半导体行业中，加强与投资者的深度沟通、提高信息披露质量是构建长期信任与共赢关系的关键。为此，公司始终秉持积极、及时的原则，不断优化投资者关系管理体系，致力于通过多渠道、多形式的沟通方式，

确保所有投资者都能公平、准确地获取公司的经营动态、财务状况、战略规划及重大事项进展等核心信息。

公司积极组织定期及不定期的投资者调研、业绩说明会等活动，还通过深交所互动易、投资者热线与邮箱、公司官网等方式听取并回应投资者的关切与问询，搭建起公司与投资者之间高效互动的桥梁。

2025年，为进一步加强市值管理工作，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司依据《公司法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律法规，制定了《市值管理制度》，并经2025年4月10日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，为公司开展市值管理奠定了制度基础。

公司在聚力价值创造的同时，积极承担社会责任，将ESG管理作为可持续发展与市值管理的核心支撑。2025年公司首次披露了环境、社会及治理（ESG）报告，积极响应全球可持续发展趋势，展现公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的实践与成果，让更多关注可持续发展的投资者更加了解公司，公司坚持与广大投资者携手并进，共创辉煌。

## **五、完善公司治理，坚持规范运作，提高信息披露质量**

公司始终致力于完善公司治理结构，坚持规范运作的原则，深入优化内控管理体系，有效降低各环节风险水平，为公司股东合法权益提供有力保障。良好的公司治理是企业持续健康发展的基石，而规范运作则是维护投资者权益、增强市场信任的关键。

2025年，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关规定，公司于2025年12月完成取消监事会改革工作，监事会职权依法由董事会审计委员会行使，并在董事会中增设1名职工代表董事。同时，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，系统性制定并修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总裁工作细则》《信息披露管理制度》等17项公司治理制度，进一步完善了公司制度体系，为公司规范运作提供坚实制度保障。

2025年，公司依法规范召开股东会3次、董事会会议7次，监事会会议5次，对定期报告、利润分配、公司治理及《公司章程》修订等重大事项进行科学

有效决策。同时，我们高度重视信息披露工作，严格遵守相关法律法规和监管要求，确保信息的真实性、准确性、完整性和及时性，为投资者提供清晰、全面的公司运营状况和发展前景。公司已连续4年在深圳证券交易所年度信息披露考评中获得“A级”。通过这些努力，我们旨在构建一个高效、负责任的企业形象，与投资者携手共创美好未来。

展望未来，公司将扎实落实“质量回报双提升”行动方案，进一步提升经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。同时，公司将继续坚持以投资者为本，通过良好的业绩表现、规范的公司治理、高质量的信息披露和积极的投资者回报，切实增强投资者的获得感，为稳市场、稳信心积极贡献力量。

本次评估情况是基于公司目前经营情况和外部环境做出的，未来可能会受到政策调整、行业发展、国内外市场环境等因素的影响。方案所涉及的公司规划、发展战略等是非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

**通富微电子股份有限公司董事会**

**2026年4月16日**